finetech

FINEPLACER® pico 2

多目的ダイボンダ

試作.研究部門での最強の装置

- 様々な実装プロセス対応（接着剤はんだ熱圧着超音波）はんだリフローにも対応
- 全プロセスへのアクセスと容易なプログラミング

幅広い対応コンポーネントサイズ

実行中プロセスの観察

将来に渡る機能拡張を可能にするモジュールプラットフォーム

フルオートまたはセミオートを選択可能な装置バリエーション

広範囲ボンディングエリア

費用対効果の高い装置構成

特長

利点

特長	利点
固定式ビームスプリッターによるオーバーレイビジョンアライメントシステム(VAS)	チップと基板の高精度ビジュアルアライメント
アライメント時 RGB LED 照明の選択の自由度	小型卓上型装置に於いて簡易なアライメント方法と優れた解像度を提供
データ及びメディアでの記録機能とレポート管理機能	包括的なプロセス記録と解析のためのプロセスパラメータのトレーサビリティ
タッチスクリーン操作による全てのプロセスへのアクセスと容易な視覚的プログラミング	プロセスシーケンスの高速構築と直感的なプロセス実装
ファインテックプラットフォームに採用されたプロセスモジュールの互換	確立されたプロセスパラメーターをシステム間に横展開
プロセスモジュールによる個別構成	アプリケーション要件に合わせたオーダーメイドのソリューション
広範囲に制御可能なボンディングフォース	1つのシステム内で高低様々なボンディング荷重を使用できることによる多様なボンディングテクノロジー要件への対応
定義済みパラメータによるシーケンス制御	直感的かつ分かりやすいプロセスフローによる適切なプロセス手順の構築

実装方式

- » 焼結法
- » 熱圧着ボンディング
- » 超音波/超音波熱圧着ボンディング
- » はんだ方式/共晶はんだ方式
- » 接着剤ボンディング

対応プロセス

- » フリップチップボンディング（フェースダウン）
- » 高精度ダイボンディング（フェースアップ）
- » ウエハーレベルパッケージング (FOWLP, W2W, C2W)
- » 3Dおよび2.5D ICパッケージング
- » チップオングラス (CoG)
- » チップオンフレックス/フィルム (CoF)
- » グラスオングラス
- » フレックスオンボード
- » チップオンボード (CoB)

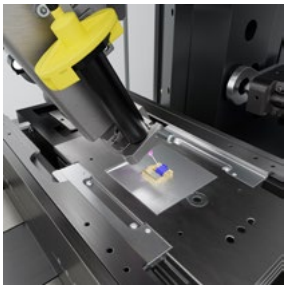
アプリケーション

- » X線検出器アセンブリ
- » インクジェットプリントヘッドアッセンブリ
- » RFIDモジュールアセンブリ
- » RF/HFモジュールアセンブリ
- » IGBTアッセンブリ
- » 超音波トランシーバーアセンブリ
- » 汎用MEMSアセンブリ
- » 加速度センサーアセンブリ
- » ガス圧力センサーアセンブリ
- » 汎用MOEMSアセンブリ
- » イメージセンサーアセンブリ
- » NFCデバイスパッケージング
- » 機構部品アセンブリ

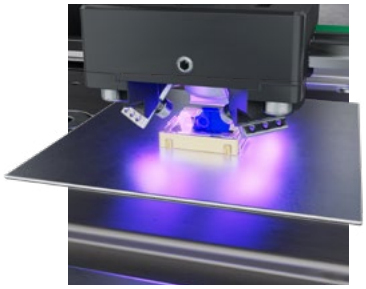
モジュール及びオプション

- » ギャップ調整モジュール
- » コンポーネント供給
- » ボンディング荷重モジュール（自動）
- » ボンディング荷重モジュール（手動）
- » Y方向カメラシフト機能
- » チップ加熱モジュール
- » ダイレクトコンポーネントプリントモジュール
- » ディスペンサーモジュール
- » フォームジェネレータ
- » ギ酸ガスモジュール
- » デッピング/スタンピングモジュール
- » 光学系シフト機能
- » プロセスガス選択
- » プロセスガスモジュール
- » プロセスビデオモジュール
- » 基板サポート
- » 基板加熱モジュール
- » ツール交換モジュール
- » 超音波モジュール
- » UV硬化モジュール

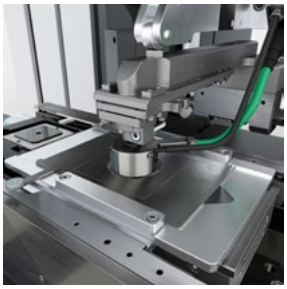
プロセスビデオモジュール



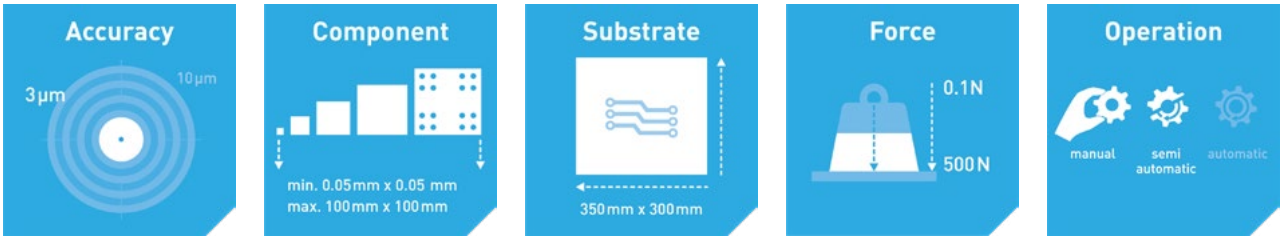
ディスペンサーモジュール



UV硬化モジュール



プロセスガスモジュール

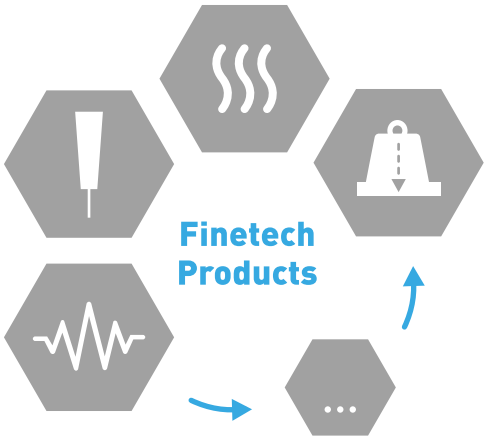


試作研究開発から量産へのシームレスな移行

これまで、あなたの有望な製品のアイデアは、開発から量産までの過程でどれだけ失われたでしょうか。ダイボンダーの技術的な制約や、投資に対するリターンが不透明なために、実行に移せなかったのではないでしょうか。生産要件に合わせて試作プロセスを自動化しようとして、行き詰まったことはないでしょうか。

ファインテックのPrototype-to-Production（プロトタイプからプロダクションまで）アプローチでは、技術的な自由度を維持しながら、研究開発から生産までのプロセスを、1対1で確実に移行することができるため、市場投入までの時間を短縮し、投資リスクを最小限に抑えることができます。

資料のダウンロードはこちら：



モジュール化の効果

FINEPLACER®には、数多くのプロセスモジュールや機能モジュールが用意されているため、非常に幅広い用途に対応することが可能です。この柔軟性により、初期段階ではその時点のニーズに適合した構成が選択可能です。さらに、私たちのシステムにはその耐用年数全体にわたって、新しいタスクに追加対応することができます。これが我々の装置の重要なコンセプトの一つです。モジュールは容易に組み合わせたり交換したりできるためシステムの柔軟性が高まり、長期的に投資を無駄にせずに済みます。

カスタマーフィードバック

"We use a Finetech die bonder for complex flip chip, sensor and opto-electronics applications, along with co-development of new assembly processes for leading semiconductor customers. The bonder has allowed us to help customers develop, optimize, verify and enhance many state-of-the-art technologies."

Dhiraj Bora
CEO & President, Silitronics

Technical information and specifications are subject to change without prior notice
© Finetech GmbH & Co. KG